

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b4) 有機RDLインターポーザの微細化製造技術開発	TOPPAN株式会社

以上